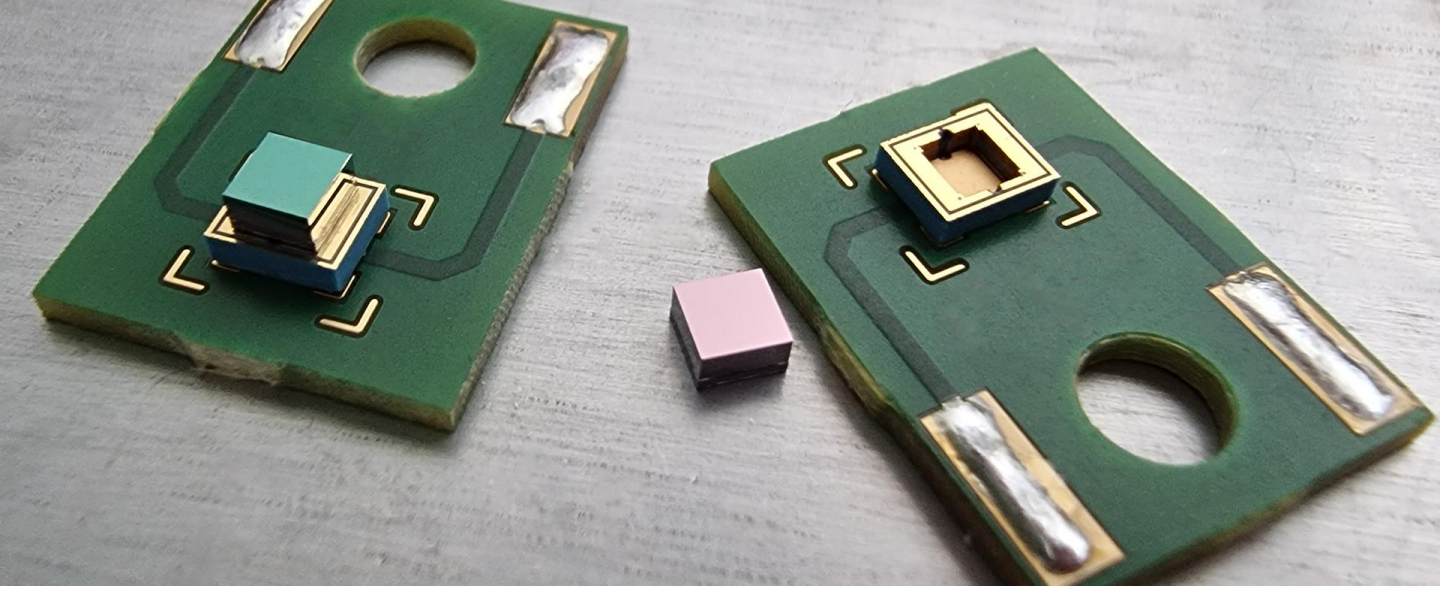


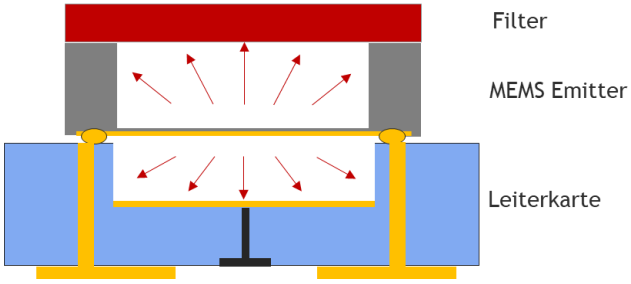
Kosteneffiziente Hausung für IR-Emitter (KHIS)

ANWENDUNG

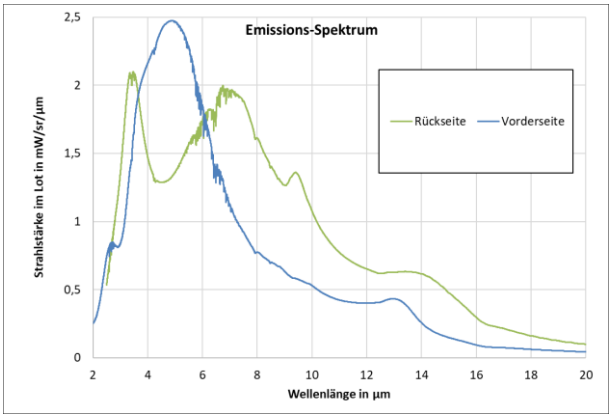
Bei MEMS-IR-Emittern muss das Package mehrere essenzielle Funktionen erfüllen, wie z.B. Dichtheit, optische Filterung oder Fenster, Wärmeableitung sowie einfache Integrationsmöglichkeit in Schaltungen und elektronische Sensorsysteme.

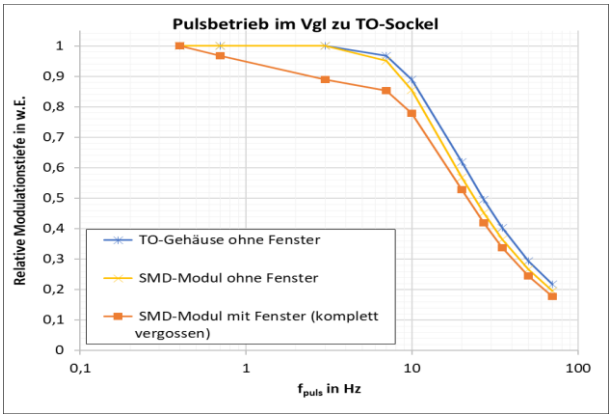
Eine neuartige, skalierbare Gehäuseplattform für MEMS-IR-Emitter realisiert SMD-kompatibles Package auf herkömmlichen FR4-Leiterkarten-material sowie auch auf keramischen Trägern (LTCC). Das Layout ist flexibel an verschiedene Chipgrößen anpassbar.

DEMONSTRATOREN



SPEKTRUM UND DYNAMIK AUF LTCC-TRÄGER





Gefördert durch:
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages

Die beschriebenen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten werden im Forschungsprojekt „Kosteneffiziente Hausung für IR-Emitter“ (KHIS) durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) gefördert.
FKZ: 49MF220218

CiS Forschungsinstitut für Mikrosensorik GmbH
Konrad-Zuse-Str. 14, 99099 Erfurt, Germany
+49 361 6631410 info@cismst.de www.cismst.de

© 2026 CiS Forschungsinstitut für Mikrosensorik GmbH